

半导体行业PLASMA处理 及性能检测整体解决方案

清洗

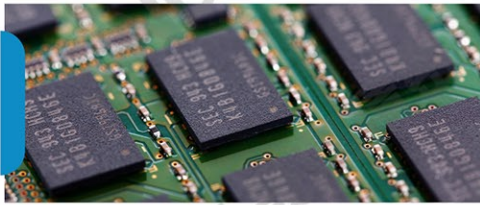
活化

除胶

刻蚀

检测

针对半导体行业设计的PLASMA处理及性能检测整体解决方案
可根据产品特性及客户需求,提供射频等离子自动化系统或微波等离子自动化系统
并提供完善的在线式及腔体式产品系列予以选择

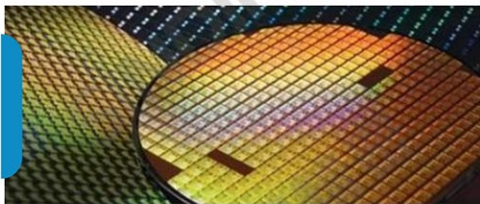


芯片粘接前处理

去除材料表面污染物,增加表面润湿性能,
提升胶体流动性,保证与其他材料的结合能力。

塑封前处理

去除材料表面污染物,使芯片表面与塑封材
料结合牢固,减少分层与气泡等不良的产生。

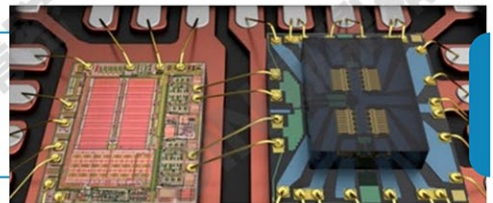


光刻胶去除

去除残留的光刻胶及其他有机物,活化和粗化
晶圆表面,提高晶圆表面润湿性能。

金属键合前处理

去除金属焊盘上的有机污染物,提高焊接
工艺的强度和可靠性。

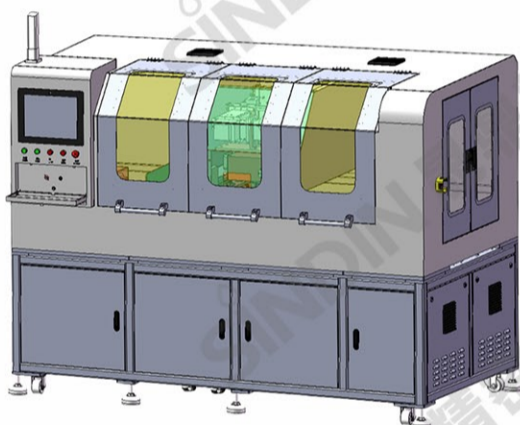


微波等离子清洗机

通过微波高能电磁场激发通入的工艺气体，使其电离产生等离子体，并直接作用在产品表面进行清洗、活化、除胶、刻蚀。



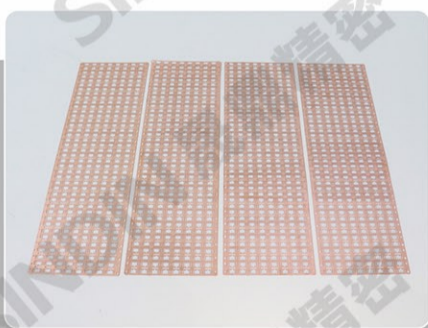
(SPV-24M) ▼



- 轨道间距可调，兼容性强，兼容产品长80-280mm×宽25-90mm。
- 等离子体不带电，不会对精密电路造成损害。
- 四道同时上料，提升产能。
- 电离度高，等离子密度大，清洗效果较好。
- 高压源和发生器互相隔离，安全性高。
- 采用磁约束的方式，微波结和磁路可以兼容。

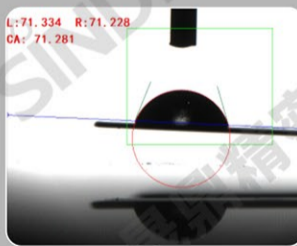
设备尺寸	长2308mm×宽1360mm×高2064mm
微波电源	双微波电源2000W
容积	约24L
清洗产品范围	80-280mm×25-90mm(长×宽)
料盒尺寸范围	180-290mm×28-93mm×200mm(长×宽×高)
真空泵	干泵
气路配置	标配氧气、氩气两路工艺气体(可定制CF4气体)
系统控制	工控系统

微波在线片式真空等离子清洗机

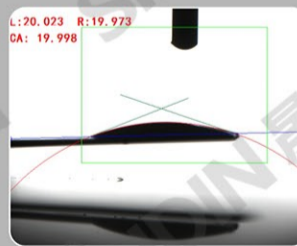


引线框架处理

微波处理引线框架，处理效果好，且均匀性更高。



处理前接触角71.28°



处理后接触角19.99°

Fr4板刻蚀 ▼

Fr4板处理前

实验序号	刻蚀前 (g)	刻蚀后 (g)
A	11.17	10.92
B	11.14	10.88
C	11.19	10.82

Fr4板处理后

引线框架还原处理 ▼

处理前

处理后